

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, D., Turnip, K., Purba, D., & Ambarita, I. (2018). *Prosiding Konferensi Nasional Engineering Perhotelan IX-2018 (xxx-xxx) Pengaruh jarak antar Katoda-Anoda pada Elektroplating terhadap tebal, korosi, dan juga interphase Lapisan Nikel.*
- Basmal, Bayuseno, & Nugroho, S. (2012). *PENGARUH SUHU DAN WAKTU PELAPISAN TEMBAGA-NIKEL PADA BAJA KARBON RENDAH SECARA ELEKTROPLATING TERHADAP NILAI KETEBALAN.* <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi-23->
- Basori, B., Soegijono, B., Yudianto, S. D., Nanto, D., & Susetyo, F. B. (2023). Effect of low magnetic field during nickel electroplating on morphology, structure, and hardness. *Journal of Physics: Conference Series*, 2596(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2596/1/012014>
- Budiyanto, E., Setiawan, D. A., Supriadi, H., & Ridhuan, K. (2016). Pengaruh Jarak Anoda-Katoda Pada Proses Elektroplating Tembaga Terhadap Ketebalan. *Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro*, 21–29.
- Diah Andayani, R., Zahara Nuryanti, S., Afriany, R., & Rais, A. (2016). Analisa Pengaruh Jarak Katoda Dan Anoda Dalam Proses Elektroplating Aluminium Terhadap Ketebalan Lapisan. *Jurnal Teknik*, 142–152.
- Engkos Kosim, M., Siskayanti, R., Prambudi, D., & Diah Rusanti, W. (2022). *Perbandingan Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Dari Kulit Singkong Dengan Karbon Aktif Komersil Terhadap Logam Tembaga Dalam Limbah Cair Electroplating (Vol. 7).*
- Guang, Y., Ying, D., Sheng, Y., Yiyong, F., Jun, W., Shuqiang, G., & Rong, J. (2019). Early Doppler Ultrasound in the Superior Mesenteric Artery and the Prediction of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Neonates. *Journal of Ultrasound in Medicine*, 38(12), 3283–3289. <https://doi.org/10.1002/jum.15064>
- Langgeng, Pratama Hendra Saputra, & Sodiwiryo Kusetyono Lamiran. (2024). Alat Elektroplating Berbasis Pengatur Waktu Untuk Pelapis Chrome Di Laboratorium Pelapis Logam. *Otopro*, 65–70. <https://doi.org/10.26740/otopro.v19n2.p65-70>
- Murdoch, H. A., Yin, D., Hernández-Rivera, E., & Giri, A. K. (2018). Effect of applied magnetic field on microstructure of electrodeposited copper. *Electrochemistry Communications*, 97, 11–15. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2018.09.013>
- Polgan, J. M., & Saragih, M. F. (n.d.). *Simulasi Pengendali Kecepatan Motor DC Seri Dengan Menggunakan Penyearah Terkendali Penuh Berbasis PSIM.*

- Sitorus, A. L., Sihotang, S., & Nugraha, A. W. (2024). *Analisis Kosentrasi Pelarut Dan Kuat Arus Terhadap Kualitas Pelapisan Logam Perak (Ag) Pada Logam Tembaga (Cu)*.
<http://jurnal.stkipggritulugagung.ac.id/index.php/eduproximaEDUPROXIM>
A6
- Soegijono, B., Susetyo, F. B., Yusmaniar, & Fajrah, M. C. (2020). Electrodeposition of paramagnetic copper film under magnetic field on paramagnetic aluminum alloy substrates. *E-Journal of Surface Science and Nanotechnology*, 18, 281–288. <https://doi.org/10.1380/EJSSNT.2020.281>
- Suarsana I Ketut. (2008a). Pengaruh waktu pelapisan nikel pada tembaga dalam pelapisan khrom dekoratif terhadap tingkat kecerahan dan ketebalan lapisan I Ketut Suarsana. In *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM* (Vol. 2, Issue 1).
- Suarsana I Ketut. (2008b). Pengaruh waktu pelapisan nikel pada tembaga dalam pelapisan khrom dekoratif terhadap tingkat kecerahan dan ketebalan lapisan I Ketut Suarsana. In *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM* (Vol. 2, Issue 1).
- Susetyo, F. B., Soegijono, B., & Yusmaniar. (2021). Effect of a constant magnet position and intensity on a copper layer obtained by DC electrodeposition. *International Journal of Corrosion and Scale Inhibition*, 10(2), 766–782. <https://doi.org/10.17675/2305-6894-2021-10-2-18>
- Syamsuir, S., Susetyo, F. B., Soegijono, B., Yudianto, S. D., Basori, & Nanto, D. (2023). Nickel layers properties produced by electroplating were influenced by spinning permanent magnet. *Journal of Physics: Conference Series*, 2596(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2596/1/012008>
- Syamsuir, Susetyo, F. B., Soegijono, B., Yudianto, S. D., Basori, Ajiriyanto, M. K., Edbert, D., Situmorang, E. U. M., Nanto, D., & Rosyidan, C. (2023). Rotating-Magnetic-Field-Assisted Electrodeposition of Copper for Ambulance Medical Equipment. *Automotive Experiences*, 6(2), 290–302. <https://doi.org/10.31603/ae.9067>
- Wahyudi Soleh, Soepriyanto Syoni, Mubarak Mohammad Zaki, & Sutarno Sutarno. (2019). Pengaruh Konsentrasi Tembaga dan Rapat Arus terhadap Morfologi Endapan Elektrodposisi Tembaga. *Al-Kimia*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/al-kimia.v7i2.7818>